

INTEL SẼ TUNG RA CHIP LỖI KÉP MỚI TRONG THÁNG 6

Sự kiện này sẽ được Intel chính thức công bố tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel (IDF) tổ chức vào tuần tới. hững sản phẩm sẽ được tung ra lần này là chip Xeon lõi kép dành cho các loại máy chủ - tên mã là Dempsey và

Sự kiện này sẽ được Intel chính thức công bố tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel (IDF) tổ chức vào tuần tới. hững sản phẩm sẽ được tung ra lần này là chip Xeon lõi kép dành cho các loại máy chủ - tên mã là Dempsey và Woodcrest - nhằm thay thế cho dòng chip Paxville hiện đang có trên thị trường. Người phát ngôn của Intel Scott McLaughlin cho biết: "Tại diễn đàn IDF năm nay chúng tôi sẽ chính thức thông báo Intel sẽ cung cấp chip Dempsey trong quý I và chip Woodcrest trong nửa cuối năm nay." Theo nhà phát triển thì chủng loại chip mới sẽ giúp các nhà sản xuất máy tính cung cấp ra thị trường các hệ thống nhỏ hơn và mát hơn. Bên cạnh đó, chủng loại bộ vi xử lý mới còn có thể nâng cao tốc độ hệ thống vì chúng cho phép người sử dụng chạy song song các ứng dụng thay vì việc các ứng dụng phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mình như trước đây, Paul Miller - phó chủ tịch phụ trách marketing cho các sản phẩm Máy chủ công nghiệp chuẩn và máy chủ BladeSystem của HP - cho biết. "Tốc độ của các bộ vi xử lý sẽ không còn được tính bằng megahertz nữa mà tính bằng số lượng các nhân tích hợp trên nó. Hầu hết các ứng dụng ngày nay đều có đa luồng nhằm tận dụng hết khả năng này," Miller khẳng định. Một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường rất sốt sắng chờ đợi thế hệ chip mới của Intel là vì công nghệ chip Paxville đã gây thất vọng cho người sử dụng. Theo nhà phân tích Gordon Haff, Intel đã thiết kế nhanh chóng dòng chip này chỉ để cạnh tranh với đối thủ AMD. "Nói cách khác, nếu không có AMD thì dòng chip Paxville DP đã không ra mắt thị trường. Chip Dempsey và Woodcrest mới được Intel thiết kế cẩn thận và là chip lõi kép thực sự," Gordon nói.